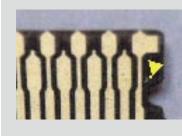
はんだ上がり欠陥



「コメント】 FPC FPC 顕微鏡倍率× 「注释! FPC 显微镜倍率 × [Coments] FPC Magnification: ×

## 1-6-2 その他(残銅)/其它(残余铜)/Others(residual copper)

## 1-6-2-1 ET ノズル詰り残銅/ ET 喷嘴堵塞的残余铜 / Residual copper by clogged etching nozzle

【特徴】裾残り状に出来ている残銅で、短絡などと同居していることも多。発生が E T コンベアの流れに平行な特定列上に限定され、不良が発見される迄のロット全数に発生

【特征】有末端的残余铜,多数与短路等不良并存。 发生位置限于 ET 流动方向平行的特定列,发现时整 个批号都不良。

**[Characteristics]** Residual copper in tailed form. Frequently coexists with short. It is formed only along a specific line parallel to the moving direction of the etching conveyor. All the products of a lot are affected until the fault is found.

【起因・判断ポイント・発生工程】ETノズルが詰まって、そのノズルからET液が出なくなった為その部分のETが損なわれて出来たもの(ET工程)

【原因、判断要点、发生工序】ET 喷嘴堵塞,不能喷射 ET 液,影响该部分的 ET 而发生的(ET 工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment] Reduced spray of etchant due to clogged nozzle prevents etching on this area to cause the defect. (Etching process)



[コメント] 顕微鏡倍率× [注釋] 显微镜倍率×